

Спад амплитуды сигналов A_2 в порошках иттриевых алюмоферрогранатов с увеличением X объясняется уменьшением величины B_1 . В образцах МЦФ константа магнитострикции, напротив, увеличивается (до 30 %) с ростом дозы облучения, что связано с перезарядкой ионов железа.

Таким образом, проведенные исследования показывают возможность дополнительного увеличения сигналов МАЭ за счет создания в порошках ферритов дефектов, что позволит значительно уменьшить энергоемкость устройств обработки информации.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Шутилов В.А., Анджеикович И.Е., Комашня В.Л., Гендельев С.П. // Письма в ЖЭТФ. 1985. Т. 10. В. 9. С. 565-568.
- [2] Шутилов В.А., Чарная Е.В., Котов Л.Н., Кулешов А.А., Сарнацкий В.М. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 17. С. 1060-1063.
- [3] Котов Л.Н. Исследование двух и трехимпульсного эха в порошках ферритов. Деп. ст. № 7118-В86. 1986. С. 2-19.
- [4] Ефиценко П.Ю., Котов Л.Н., Чарная Е.В. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 8. С. 2424-2428.
- [5] Лебедь В.М., Абаренкова С.Г. // ФТТ. 1964. Т. 6. № 1. С. 297-300.
- [6] Сарнацкий В.М., Котов Л.Н., Ефиценко П.Ю. Тез. 14 Всес. конф. по акустоэлектронике и квантовой акустике. 1989. Ч. 2. С. 33-35.

Ленинградский
государственный университет

Поступило в Редакцию
17 июля 1989 г.
В окончательной редакции
15 ноября 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 1

12 января 1990 г.

05.3; 07

© 1990

ТЕОРИЯ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ОДНОРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Н.П. Фурзиков

Абляционная обработка полимерных материалов импульсным УФ излучением эксимерных лазеров применяется в микроэлектронике, офтальмологии и др. На качественном уровне абляция объясняется двумя моделями: фотохимический и термической, однако они не способны предсказать наблюдаемые на опыте значения порогов и

глубин снимаемого за импульс слоя. Ниже изложена простая количественная теория этого процесса.

При поглощении УФ излучения и последующей релаксации возбуждения поверхность полимера нагревается. Если в результате нагрева скорость термодеструкции

$$W = A \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) \quad (1)$$

(A – предэкспоненциальный множитель, E – энергия активации, R – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура) превышает скорость ввода энергии, т. е. обратную длительность лазерного импульса, то процесс приобретает все черты аблации. Для полиметилметакрилата (ПММА), например, и наносекундных импульсов требуемая температура составляет около 1100 К [1].

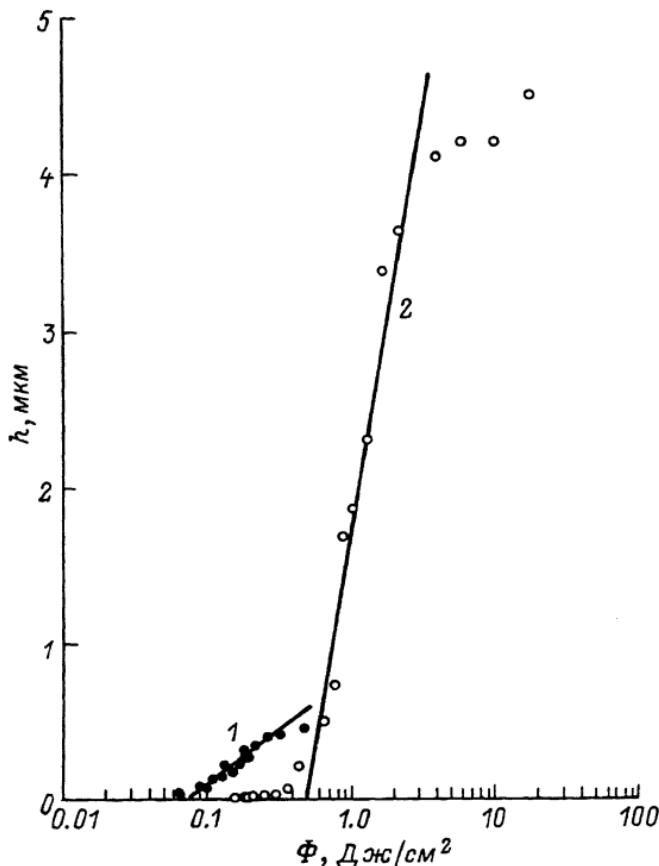
Если интенсивность излучения невысока, а квантовый выход фотокимии и диффузии тепла пренебрежимо малы, то нагрев поверхности хорошо известен:

$$\Delta T_1 = \frac{\alpha \phi}{\rho C}, \quad (2)$$

где α – коэффициент поглощения, ϕ – плотность энергии излучения, ρ – плотность полимера, C – его теплоемкость. Реальная микршероховатость поверхности среды приводит к тому, что локальная объемная плотность поглощенной энергии и нагрев определяются интерференцией прошедшей волны и волн, дифрагировавших на модуляциях границы раздела. Зависимость (1) обеспечивает положительную обратную связь, вызывающую рост амплитуды модуляции, причем при нормальном падении излучения наиболее быстро растет решетка с периодом, близким к длине волны [2]. В нелинейном режиме амплитуда решетки стабилизируется на уровне, соответствующем периодически полному преобразованию падающей накачки в поверхностные волны [3, 4]. В условиях аблации эти волны могут быть представлены только излучательными модами, после которых локализовано на поверхности полимера [5]. Это значит, что поглощение энергии в течение импульса периодически соответствует поверхностному тепловыделению, для которого нагрев поверхности дается формулой (в случае прямоугольного импульса)

$$\Delta T_2 = 2I \left(\frac{t}{\pi \chi \rho C} \right)^{1/2}, \quad (3)$$

где I – интенсивность, t – время, χ – теплопроводность. Средний в течение импульса нагрев равен $\Delta T = (\Delta T_1 \cdot \Delta T_2)^{1/2}$. При близкой к треугольной, слабо асимметричной форме импульса излучения эксимерных лазеров максимум температуры достигается в момент времени, примерно равный длительности импульса на полувысоте $t_{1/2}$ от его начала. С учетом $I = \frac{\phi}{2t_{1/2}}$ это дает для плотности энергии всего импульса



Расчетные (линии) и экспериментальные (символы) зависимости глубины аблации ПММА импульсным лазерным излучением с длинами волн 193 (1) и 248 нм (2) от плотности энергии. $\rho = 1.2 \text{ г}/\text{см}^3$, $C = 1.46 \text{ Дж}/\text{г}\cdot\text{К}$, $\alpha = 1.6 \cdot 10^{-3} \text{ Вт}/\text{см}\cdot\text{К}$, $n = 1.49$, $\alpha(193) = 4500 \text{ см}^{-1}$, $\alpha(248) = 100 \text{ см}^{-1}$ [5-7].

$$\Phi \approx 24T(2\alpha)^{-1/2} (\pi \rho^3 C^3 \alpha t_H)^{1/4}. \quad (4)$$

При подстановке значений $4T$, соответствующих условию $W = t_H^{-1}$, формула (4) определяет пороги аблации.

Глубина аблации при заданной плотности энергии определяется положением фронта температуры, соответствующего нагреву $4T$. Проникновение накачки вглубь полимера характеризуется величиной α^{-1} , излучательных мод – стационарной амплитудой поверхностной решетки. При случайной поляризации и слабой фокусировке излучения эксимерных лазеров эта амплитуда равна [3]

$$\frac{\lambda(\sqrt{2}+1)}{2\pi\sqrt{2n}} = B\lambda. \quad (5)$$

Среднее за импульс положение температурного фронта характеризуется величиной $\left(\frac{B\lambda}{\alpha}\right)^{1/2}$. Для глубины аблации за импульс имеем

$$h(\phi) \approx \left(\frac{B\lambda}{\alpha}\right)^{1/2} \ln\left(\frac{\phi}{\phi_{пор}}\right). \quad (6)$$

На рисунке приведены расчетные зависимости $h(\phi)$, полученные для ПММА по формулам (4, 6) с использованием стандартных значений теплофизических постоянных и показателя преломления [6]. Здесь же показаны соответствующие экспериментальные данные [7]. Видно хорошее совпадение теории и эксперимента при средних плотностях энергии. Существование плавного перехода от нулевых глубин аблации к зависимости (6) вместо резкого порога объясняется тем, что термодеструкция полимера, согласно (1), имеет конечную скорость и при температурах, меньших „пороговой“. Насыщение экспериментальных глубин аблации при высоких плотностях энергии, по-видимому, обусловлено экранировкой излучения продуктами, выбрасываемыми в ходе импульса. Изложенная теория пригодна для описания аблации полимеров, обладающих высокими коэффициентами поглощения, но в этом случае необходимо учитывать диффузию тепла в течение импульса излучения.

Автор благодарит В.Н. Семиногова за полезное обсуждение и препринт [4].

Список литературы

- [1] Venkatesan T. et al // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 60. P. 382.
- [2] Ахманов С.А., Емельянов В.И., Коротеев Н.И., Семиногов В.Н. // УФН. 1985. Т. 147. С. 675.
- [3] Емельянов В.И., Семиногов В.Н. // Квантовая электроника. 1987. Т. 14. С. 47.
- [4] Семиногов В.Н., Худобенков А.И. Препринт НИЦТЛ АН СССР. Шатура Московской обл. 1988. № 56.
- [5] Когельник Г. Интегральная оптика, М.: Мир, 1978. С. 26.
- [6] Новиченок Л.Н., Шульман З.П. Теплофизические свойства полимеров. Минск: Наука и техника, 1971.

Научно-исследовательский центр
по технологическим лазерам АН СССР

Поступило в Редакцию
3 августа 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 1

12 января 1990 г.

06.2

© 1990

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПОДЛОЖКЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАВИННЫХ ФОТОПРИЕМНИКОВ

А.Г. Гасанов, В.М. Головин, З.Я. Садыгов,
Н.Ю. Юсипов

Известно, что одним из недостатков, ограничивающих применение полупроводниковых лавинных фотодиодов для регистрации слабых потоков оптических квантов и ядерных частиц, является присутствие (или образование при эксплуатации) в них отдельных областей микроприбора (микроплазмы). Центрами микроплазмы обычно являются такие неоднородности в полупроводниковой подложке, как дислокация атомов основного вещества, локальные скопления примесей, форма и чистота границ разделов и другие искажения кристаллической решетки, приводящие к неуправляемому развитию лавинного процесса в приборе [1].

Значительное ослабление микроплазменных процессов достигается в многослойных структурах металл – буферный слой – полупроводник на основе систем кремний – двуокись кремния ($Si - SiO_2$) [2, 3] и кремний – карбид кремния ($Si - SiC$) [4, 5]. В этих структурах за счет возможности накопления размноженных носителей заряда на границе полупроводник – буферный слой обеспечивается локальная отрицательная обратная связь в областях микроплазмы, приводящая к стабилизации лавинного процесса по всей рабочей площади прибора.

В данном сообщении изучено влияние искусственно созданных неоднородностей на границах раздела $Si - SiO_2$ и $Si - SiC$ на величины коэффициента усиления фототока и напряжения пробоя, соответствующего началу лавинного процесса в структурах.

В рабочем режиме к электродам структур прикладывалось импульсное (в случае системы $Si - SiO_2$) или постоянное (в случае системы $Si - SiC$) напряжение V с полярностью, соответствующей обеднению границы раздела полупроводник – буферный слой. В качестве источника света использовался светодиод с длиной волны излучения $\lambda = 0.67$ мкм. Коэффициент усиления в структурах опре-